



NEWS ANNOUNCEMENT

FOR IMMEDIATE RELEASE

※本リリースは 2021 年 8 月 16 日に発表されたリリースを翻訳したものです

タワーセミコンダクターとケイデンスが 5G 通信と車載用の先端 IC 開発向けの 新しいリファレンスフローを発表

ハイライト:

- コラボレーションによる *Virtuoso Design Platform* と統合 EM 解析を使用したシリコン検証済み SP4T RF SOI スイッチリファレンスフローが実現
- チップとパッケージの共通設計とシミュレーションのための統一設計環境のフローのメリット
- 包括的なフローには、カスタム IC 回路設計手順、EM ソルバー、およびマルチフィジックス解析ツールなど、デザイナーへのより迅速なパスを提供します

カリフォルニア州サンノゼ、およびイスラエル ミグダル ハエメク 2021 年 8 月 16 日- ケイデンス デザイン システムズ (NASDAQ: CDNS)と高付加価値のアナログ半導体ファンドリソリューションのリーダーである[タワーセミコンダクター](#) (NASDAQ/TASE:TSEM)は、本日、Cadence® Virtuoso®デザインプラットフォームと高周波ソリューションを用いたシリコン検証済み SP4T RF SOI スイッチリファレンスデザインフローを発表しました。このリファレンスフローは、高度な 5G ワイヤレス、ワイヤラインインフラストラクチャ、および車載用 IC 製品開発のためのデザイナーへのより迅速なパスを提供します。

この新しい RF リファレンスデザインフローは、タワーの CMOS、BiCMOS、SOI、およびシリコンゲルマニウム(SiGe)プロセス用にチューニングされたミックスドシグナル、RF デザイン、シミュレーション、システム解析、およびサインオフツールの包括的なセットを活用しています。新しい製品を使用することで、設計者は RF、ミリ波、高性能アナログ設計を加速し、サインオフの信頼性を高めることができます。

ケイデンスのカスタム IC&PCB グループの製品管理副社長 KT Moore 氏は次のように述べています。「この独自の RF とミリ波フルフローソリューションは、タワーの CS18RF SOI ファンドリプロセスで共同で検証されました。タワーとの継続的なパートナーシップにより、さらに有益性の高いもう一つのソリューションが生まれました。これにより、高度な IC 設計が可能になりました。これは、今日の最も複雑なシステムの要件を満たしています。ケイデンスとタワーのお客様は、すべてのケイデンスツールセットとタワーリファレンスデザインを使用した統合ワークフローの恩恵を受けて、競争力のある製品を迅速に開発します。」

タワーの RF、高性能アナログデザインイネーブルメントソリューション、PDK およびリファレンスフローは、RF-SOI 用の CS18 および TPS65RS、SiGe BiCMOS 用の SBC18 など、クラス最高のファンドリワイヤレスとワイヤラインプロセス技術を補完します。RF・ミリ波 IC とパッケージの協調設計は、タワーのお客様にとって重要な課題であり、現在ではシリコン検証済みのツールとフローを備えています。設計者は、コストとパフォーマンスに最適化された差別化された IC を設計することができます。

タワーセミコンダクターの VLSI デザインセンターおよびデザインイネーブルメント担当バイスプレジデントの Ori Galzur 氏は、次のように述べています。「私たちは、お客様に新たな競争力を提供する設計能力の拡大を発表することをとても嬉しく思います。高度な設計ツールの世界的プロバイダーであるケイデンスと長期的な協業を通じて、最先端の市場で IC 設計要件に最適な独自の機能を備えた新しい高度な設計ツールを継続的に提供し、お客様に迅速かつ正確な設計サイクルタイムを実現します。」

周波数が高くなるにつれて、マルチフィジックス効果を正確に組み込む必要性が高まっています。そのため、タワーが提供可能な RF とミリ波 PDK には、Cadence Celsius™ サーマルソルバー、EMX® Planar3D ソルバー、Clarity™ 3D ソルバー技術が組み込まれており、デザインの電磁気(EM)と熱設計の完全性がシームレスに考慮されるようになりました。マルチフィジックス解析製品は、Virtuoso 環境、Spectre® シミュレーションプラットフォーム、Quantus™ 抽出ソリューション、統合 Litho 物理アナライザー、Innovus™ 実装システムなど、タワーで使用されている既存のケイデンスツールセットを補完します。チップ、パッケージ、マルチフィジックスソリューションのケイデンス製品の詳細については、www.cadence.com/go/TowerReferenceFlow をご覧ください。

タワーセミコンダクターのファンドリテクノロジーおよびデザインイネーブルメントの詳細については、[こちら](#)をご覧ください。

ケイデンスについて

ケイデンスは 30 年以上にわたる計算ソフトウェア (computational software) の専門知識を基盤とする電子設計業界のリーダーです。Intelligent System Design 戦略のもと、設計コンセプトを実現するためのソフトウェア、ハードウェア、IP を提供しています。ケイデンスのお客様は、世界で最も革新的な企業であり、コンシューマー、ハイパースケールコンピューティング、5G 通信、自動車、モバイル、航空宇宙、産業、ヘルスケアなど、最もダイナミックな市場アプリケーションに向けて、チップからボード、システムに至るまで、卓越した電子製品を提供しています。フォーチュン誌は 7 年連続で、ケイデンス社を「働きがいのある会社ベスト 100」に選出しています。ケイデンスに関する詳細については cadence.com をご参照ください。

タワーセミコンダクターについて

タワーセミコンダクター株式会社(NASDAQ:TSEM,TASE:TSEM)は、高付加価値のアナログ半導体ソリューションのファンドリリーダーで、コンシューマー、産業機械、車載用、モバイル、インフラ、医療用、航空宇宙・防衛などの成長市場で集積回路(IC)の技術・製造プラットフォームを提供しています。タワーセミコンダクターは、長期的なパートナーシップと先端の革新的なアナログテクノロジーの提供を通じて、意義あるサステナブルインパクトを創造することに注力し、SiGe、BiCMOS、ミックストシグナル / CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、non-image sensor、パワーマネジメント(BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントを提供し、IDM やファブレス企業向けにはプロセス移管サービスを提供しています。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワーセミコンダクターはイスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国に 2 か所(200mm)、TPSCo が保有する日本の 3 か所(200mm と 300mm)に生産拠点が 있습니다。詳細は www.towersemi.com をご覧ください。

###

Cadence Newsroom | 408-944-7039 | newsroom@cadence.com

Tower Semiconductor Company Contact: Orit Shahar | +972-74-7377440 | oritsha@towersemi.com

Tower Semiconductor Investor Relations Contact: Noit Levy | +972-4-604-7066 | noitle@towersemi.com